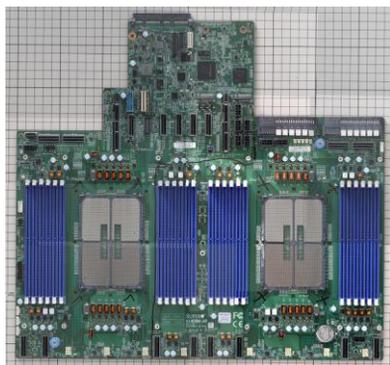
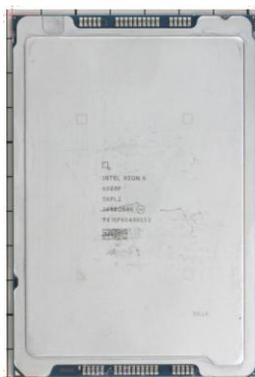


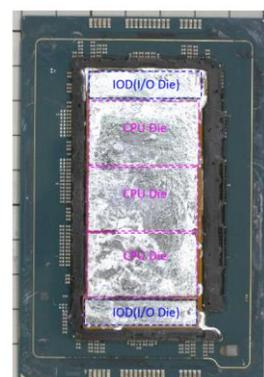
Server : Intel Xeon 6980P_Intel Xeon Server搭載 パッケージ & 基板詳細解析レポート



Main PCB



Package



Removed of heat sink

製品概要

Intel Xeon 6980P を搭載したサーバーは、次世代データセンター向けに設計された超高性能プラットフォームであり、AI推論・学習、大規模データ処理、HPC など極めて重いワークロードに対応する構成を備えています。Xeon 6980P は 128コア/256スレッドを搭載し、Granite Rapids-AP アーキテクチャを採用した最新世代の Xeon 6 系列 CPU で、5nmクラスの製造プロセスにより高い電力効率と演算性能を両立しています。基本クロックは 2.0 GHz、最大 3.9 GHz までブーストし、504MB の巨大な L3 キャッシュがメモリ集約型処理を強力に支えます。さらに、DDR5 MRDIMM (最大 8800MT/s) に対応し、最大 614GB/s 級のメモリ帯域を実現することで、大規模データセットの処理能力を大幅に向上させています。PCIe 5.0 もサポートし、高速アクセラレータや最新ストレージとの接続性も万全です。

パッケージは、3つのCPUダイと2つのIOダイが搭載されており、チップ間はEMIBで接続されています。 **EMIB: Embedded Multi-die Interconnect Bridge**

今回、以下6つのレポートをリリース予定です。

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. 基板搭載半導体部品調査 | : 25R-1057-1 |
| 2. 基板、パッケージの断面解析 | : 25R-1057-2 |
| 3. 基板平面解析(20層) 最細部のL/W測定、ODB データ | : 25R-1057-3 |
| 4. パッケージ平面解析(18層) 最細部のL/W測定、ODB データ | : 25R-1057-4 |
| 5. EMIB平面解析 (5層) 最細部のL/W測定、ODB データ | : 25R-1057-5 |
| 6. チップ解析 (断面解析、フロアプラン推定) | : 25R-1057-6 |

詳細は次ページへ

1. 製品分解、基板搭載半導体部品調査：

価格：500,000円 リリース予定：3/31

- 搭載半導体調査
- データシート（見つかった場合）
- ソケットなどの搭載部品拡大写真

2. 基板、パッケージ断面解析：

価格：250,000円 リリース予定：3/16

- パッケージX線写真
- 断面構造
- 各層厚さ測定

3-1. 基板各層（20層）最細部のL/W測定：

価格：650,000円 リリース予定：4/10

- 各層(20層)の最細部の線幅、線ピッチ測定

3-2. Option : CADデータ

価格：6,000,000円 リリース予定：4/10

- Power,GNDラインの特定
- ODB++、Gerberなど

4-1. パッケージ各層(18層)画像データ：

価格：500,000円 リリース予定：3/16

- 各配線情報（各層(12層)の写真、線幅、線ピッチ）

4-2.Option : CADデータ

価格：5,000,000円) リリース予定：3/31

- Power,GNDラインの特定
- ODB++、Gerberなど

5-1. EMIB各層(5層)画像データ：

価格：500,000円 リリース予定：3/31

- 各配線情報（各層(12層)の写真、線幅、線ピッチ）

5-2.Option : CADデータ

価格：1,200,000円) リリース予定：3/31

- ODB++、Gerberなど

6 チップ構造解析：

価格：600,000円 リリース予定：2026/3/31

- Seal Ring部SEM 断面
- Top層、ゲート層写真
- フロアプラン解析